

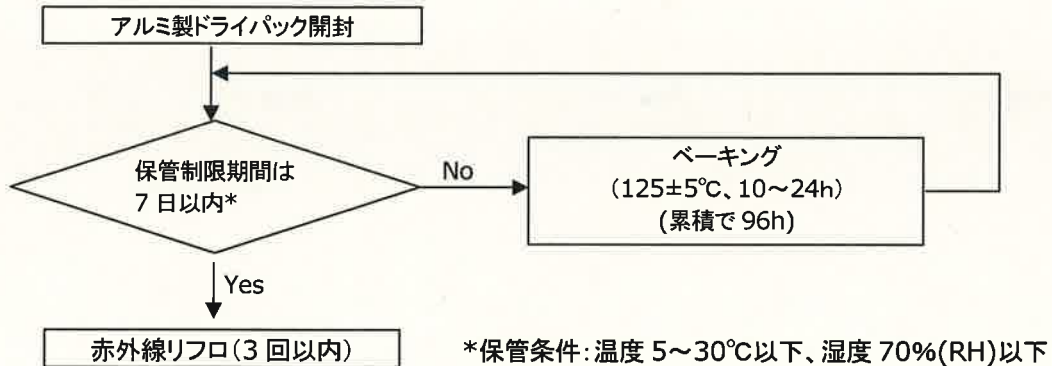
RL78/G1Aグループ「半田付け条件判定表」
 RL78/G1A GROUP "SOLDERING CONDITIONS TABLE"

R01ZZ0090XJ0100_RL78G1A_JE

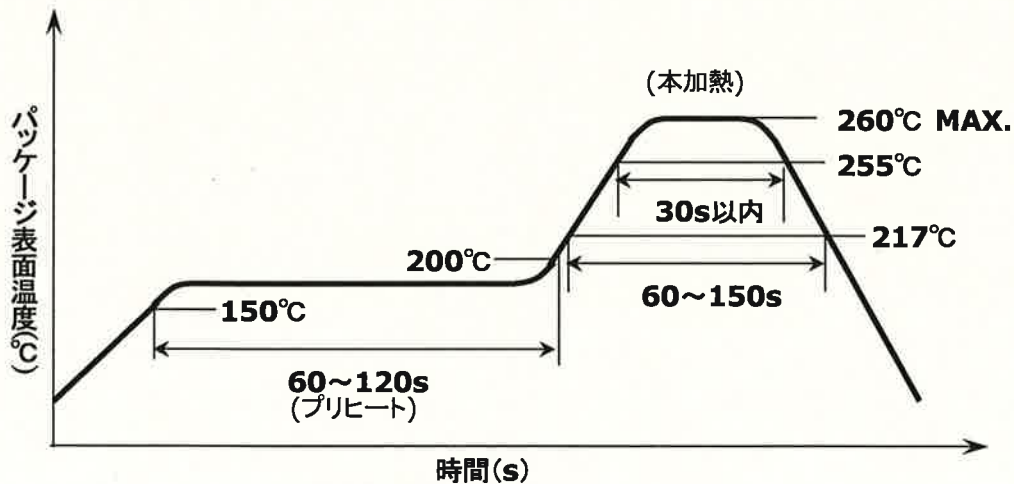
パッケージ名 Package	型名 Part Number	リフロ条件	ウェーブソルダーリング条件	部分加熱条件
		INFRARED REFLOW SSD-A-M5658-2 (JP) SSD-A-M5659-1 (EN)	WAVE SOLDERING SSD-A-M5660-3 (JP) SSD-A-M5661-1 (EN)	PARTIAL HEATING SSD-A-M5662-1 (JP) SSD-A-M5663 (EN)
25pin plastic LGA (3x3)	R5F10E8xALA	○		
	R5F10E8xGLA			
32pin plastic QFN (5x5)	R5F10EBxANA	○		
	R5F10EBxGNA			
48pin plastic QFP (7x7)	R5F10EGxAFB	○		○
	R5F10EGxGFB			
48pin plastic QFN (7x7)	R5F10EGxANA	○		
	R5F10EGxGNA			
64pin plastic QFP (10x10)	R5F10ELxAFB	○		○
	R5F10ELxGFB			
64pin plastic BGA (4x4)	R5F10ELxABG	○		
	R5F10ELxGBG			

赤外線リフロ方式のはんだ付け推奨条件 [温風、赤外線+温風リフロを含む] <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">吸湿量管理品</div>	SSD-A-M5658-2					
	2012年 6月 27日					
	ルネサスエレクトロニクス株式会社 品質保証統括部 MCU 品質保証第二部					
	承認		査 閲	—	作 成	東 口
MSL3						

赤外線リフロ方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。



- ピーク温度(260°Cの場合) : 260°C MAX
- ピーク温度(-5°C)の時間 : 255°C 30s 以内
- はんだ融点以上(217°C以上の時間) : 60~150s
- プリヒート領域(150~200°Cの時間) : 60~120s
- 最多リフロ回数 : 3回
- ドライパック開封後の保管制限期間 : 7日以内



<赤外線リフロ温度プロファイル>

留意事項

- ✓ 耐熱トレイ以外(マガジン、テーピング、非耐熱トレイ)は包装状態でのベーキングができません。
- ✓ インジケータの30%検湿部が、ラベンダー色 又は ピンク色に変化していた場合は、ベーキングを推奨致します。
- ✓ はんだ溶融温度は使用される基板やペースト材料で異なりますので、実装温度プロファイルについては、本提示条件以下で最適温度をご確認の上、ご使用お願いいたします。

**RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS
OF
INFRARED REFLOW
[INCLUDING CONVECTION,INFRARED/CONVECTION]**

Moisture sensitive device

MSL3

SSD-A-M5659-1

June 27,2012

Renesas Electronics Corporation.
Quality Assurance Division.
2nd. MCU Quality Assurance Dept.

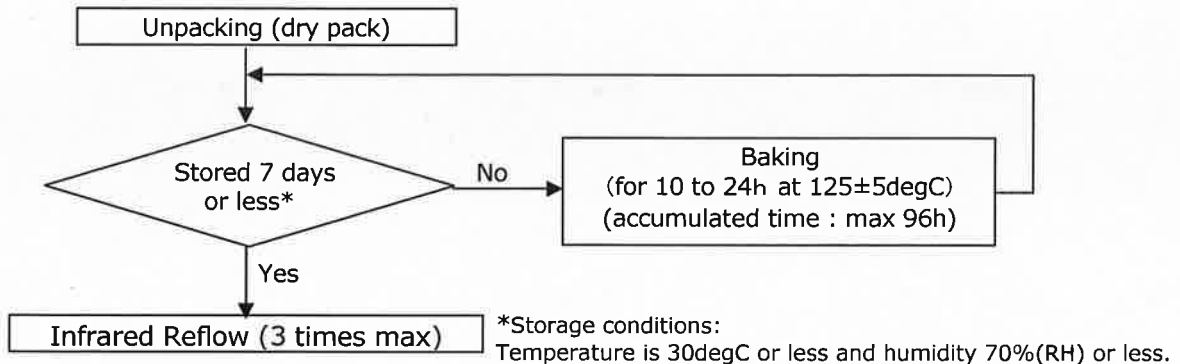
Prepared	Checked	Approved
----------	---------	----------

Higashiguchi

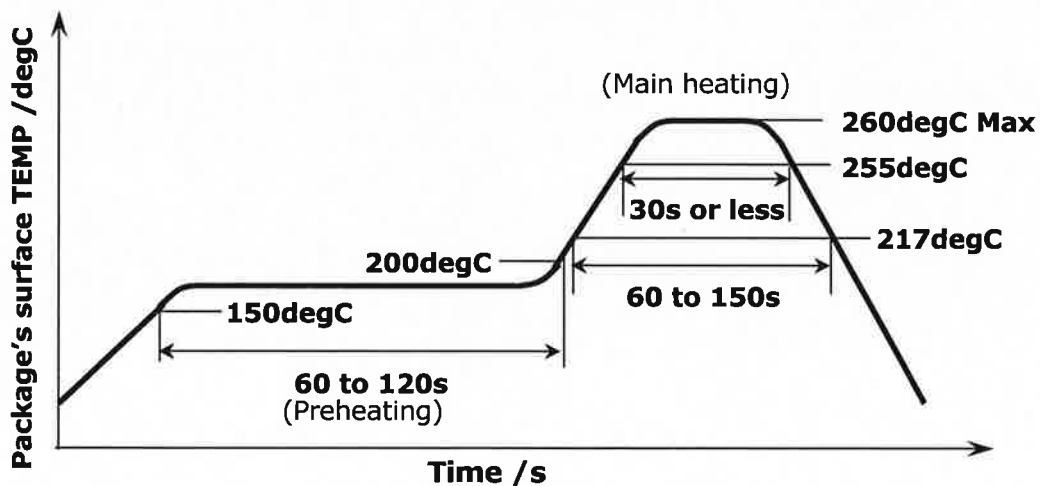
-

n. sun

The following is recommended soldering conditions of infrared reflow.




- Maximum temperature (Package's surface TEMP) :260degC or below
- Maximum time for temperature higher than 255degC :30s or less
- Time for temperature higher than 217degC :60 to 150s
- Preheating time (150 to 200degC) :60 to 120s
- Maximum number of reflow processes :3 times
- Keeping limitation period after opening dry pack :7 days or less



<Infrared Reflow Temperature Profile>

Notice

- ✓ For baking components, it is necessary to use heatproof type container. Plastic magazines, emboss tape/reels and some of trays are not heatproof type, so if the packing container is not heatproof type, please transfer them to a heatproof type container
- ✓ When the color of the humidity detection mark of 30% of the indicator has been changed into lavender or pink, it is recommended to execute the baking.
- ✓ Since solder melting temperatures differ with a substrate or the material of paste, please confirm the optimal temperature in the condition shown above before using components.

部分加熱方式のはんだ付け推奨条件 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">表面実装部品</div>	SSD-A-M5662-1					
	2011年 11月 10日					
	ルネサスエレクトロニクス株式会社 品質保証統括部 MCU 品質保証第二部					
	承認		査閲	—	作成	東口

部分加熱方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。

- 最高温度(端子温度) : 350°C以下
- 時間(パッケージの一边あたり) : 3s 以内
- 最多回数 : 1 回

**RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS
OF
PARTIAL HEATING**

Surface mount device

SSD-A-M5663

July 8,2011

Renesas Electronics Corporation.
Quality Assurance Division.
2nd. MCU Quality Assurance Dept.

Prepared

Checked

Approved

Higashiguchi

-

N. Iano

The following is recommended soldering conditions of partial heating.

- Maximum temperature (Pin temperature) :350degC or below
- Time (per side of the device) :3s or less
- Maximum number of heating processes :1time